

概要

この通知は、Virtex™ -II Pro デバイスのパッケージのレイヤ変更をお知らせするものです。

変更内容

ザイリンクスの材料標準化プロセスの一環、かつシグナル インテグリティ向上のため、フリップ チップ パッケージを使用した Virtex-II Pro ファミリ デバイス (リストを参照して下さい) を 8 レイヤ パッケージへ変更いたします。この変更は、現在量産中の 6 レイヤ パッケージと下位互換性があります。

該当製品

この変更は、XC2VP30-FF896、XC2VP30-FF1152、XC2VP70-FF1704 および XC2VP100-FF1704 の C および I 製品の温度グレード、かつすべてのスピードグレードに該当します。

キー デート

サンプル入手可能日および製造変更開始日については、次の表を参照して下さい。XC2VP30-FF1152 および XC2VP70-FF1704 デバイスの 8 レイヤ パッケージ品の量産サンプルは、現在入手可能です。XC2VP30-FF896 および XC2VP100-FF1704 の 8 レイヤ パッケージ品の量産サンプル スケジュールは、次の表を参照して下さい。8 レイヤ パッケージ品のサンプルおよび量産品は、SCD0966 を指定することにより、移行期間内でもご注文いただけます。SCD0966 をご使用の場合には、通常ご注文の製品名 (スタンダード オーダー パート ナンバー) の後に「0966」を追加して下さい (例: XC2VP70-6FF1704C0966)。SCD0966 は、各製品の移行日よりそれぞれ無効となります。6 レイヤ パッケージ デバイスの在庫品がなくなるまでは、6 レイヤ パッケージ製品と 8 レイヤ パッケージ製品のいずれかがスタンダード製品として混在出荷されます。

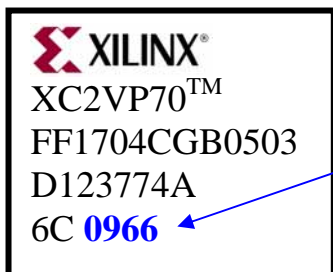
デバイス	8 レイヤ パッケージ デバイスの SCD 番号	サンプル入手可能日	変更開始日
XC2VP30-FF896	SCD0966	2005 年 11 月 1 日	2006 年 2 月 1 日
XC2VP30-FF1152	SCD0966	2005 年 8 月 1 日	2005 年 11 月 1 日
XC2VP70-FF1704	SCD0966	2005 年 8 月 1 日	2005 年 11 月 1 日
XC2VP100-FF1704	SCD0966	2006 年 2 月 1 日	2006 年 5 月 1 日

認定データ

8 レイヤ パッケージ デバイスの認定データは、[Virtex-II Pro 8-Layer Package Substrate Report](#) を参照して下さい。

トレーサビリティ

変更開始日までは、8 レイヤ パッケージ デバイスのパッケージ 4 行目にマーキングされる SCD 番号「0966」により識別できます。その後は、8 レイヤ パッケージ製品のデートコードにより識別できます。



SCD Number

推奨

この通知に対する回答の必要はありません。ご不明な点、ご質問等ございましたら [ザイリンクス テクニカル サポート](#) までお問い合わせ下さい。

重要なお知らせ : カスタマ変更通知 (PCN、PDN、Quality Alert) は、弊社のウェブサイト MySupport <http://www.xilinx.co.jp/mysupport> からの e-mail によるアラート配信として受信することができます。この MySupport で登録後、マイアラートにカスタマ変更通知が含まれるようにカスタマイズして下さい。この変更により、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるようになります。登録方法につきましては、[ザイリンクス アンサー18683](#) を参照して下さい。

改訂履歴

次の表に、この通知の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	変更内容
2005/08/01	1.0	初版リリース

この通知は、英語版 (XCN5012、バージョン 1.0、2005 年 8 月 1 日発行) を翻訳したものです。